DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat

(c) 2002 EPO. All rts. reserv.

13251685

Basic Patent (No, Kind, Date): JP 8195357 A2 19960730 < No. of Patents: 006>

LASER IRRADIATING DEVICE (English)

Patent Assignee: SEMICONDUCTOR ENERGY LAB

Author (Inventor): YAMAZAKI SHUNPEI; TANAKA KOICHIRO

IPC: *H01L-021/268; H01S-003/00

Derwent WPI Acc No: *G 96-399323; G 96-399323

Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No	Kind D	Date A	Applic No	Kind	Date		
JP 8195357	A2	19960730	JP 952	1011	Α	19950113	(BASIC)
JP 8203843	A2	19960809	JP 9527	7454	Α	19950124	
JP 3205478	B2	20010904	JP 9527	454	Α	19950124	
US 5854803	Α	19981229	US 579	9396	Α	19951227	
US 20010019	861 AA	20010906	5 US 81	1701	Α	20010320	•
US 6210996	BA	20010403	3 US 20	3613	Α	19981202	

Priority Data (No,Kind,Date):

JP 9521011 A 19950113

JP 9527454 A 19950124

US 811701 A 20010320

US 203613 A3 19981202

US 579396 A3 19951227

US 203613 A 19981202

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2002 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

Image available 05239857

LASER IRRADIATING DEVICE

PUB. NO.:

08-195357 [JP 8195357 A]

PUBLISHED:

July 30, 1996 (19960730)

INVENTOR(s): YAMAZAKI SHUNPEI

TANAKA KOICHIRO

APPLICANT(s): SEMICONDUCTOR ENERGY LAB CO LTD [470730] (A Japanese

Company or Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.:

07-021011 [JP 9521011]

FILED:

January 13, 1995 (19950113)

INTL CLASS: [6] H01L-021/268; H01S-003/00

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components)

JAPIO KEYWORD:R002 (LASERS)

ABSTRACT

PURPOSE: To provide uniform effect, such as an annealing effect, of laser irradiation to semiconductor.

CONSTITUTION: The radiation energy of an excimer laser is measured, and the excimer laser is so controlled as to radiate laser beams of constant energy. Laser beams emitted from an optical system 4 and reflected by a mirror 9 are made to irradiate a specimen 11. At this point, a beam profiler is disposed just after the mirror 9 to measure the energy of laser beams. An energy attenuator arranged between a mirror 8 and the optical system 4 is actuated and controlled so as to irradiate the specimen 11 with laser beams constant in energy basing on the measured value.

(12)公開特許公報 (A)

(19)日本国特許庁(JP)

(11)特許出願公開番号

特開平8-195357

(43)公開日 平成8年(1996)7月30日

(51) Int. Cl. 6

識別記号

FΙ

H01L 21/268

Z G

H01S 3/00

審査請求 未請求 請求項の数6 FD (全5頁)

(21)出願番号

特願平7-21011

(22)出願日

平成7年(1995)1月13日

(71)出願人 000153878

株式会社半導体エネルギー研究所

神奈川県厚木市長谷398番地

(72)発明者 山崎 舜平

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半

導体エネルギー研究所内

(72)発明者 田中 幸一郎

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半

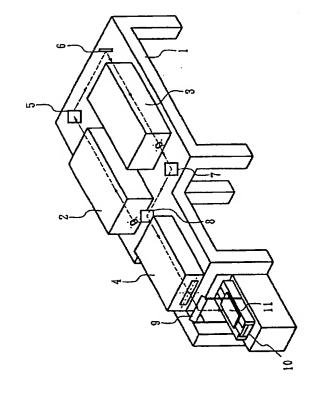
導体エネルギー研究所内

(54) 【発明の名称】レーザー照射装置

(57) 【要約】

【目的】 レーザー光の照射に従う効果、例えばレーザー光の照射に従う半導体へのアニール効果を均一なものとする。

【構成】 エキシマレーザーの照射エネルギーを測定し、常に一定のエネルギーで照射が行われるように調整する。光学系4から出て、ミラー9で反射されたレーザー光は試料11に照射される。この際、ミラー9の直後にピームプロファイラーを配置し、照射されるレーザー光のエネルギーを計測する。そして、この計測値を基にミラー8と光学系4との間に配置されたエネルギー減衰装置を作動させ、試料11に照射されるエネルギーを一定なものとなるように調整する。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 エキシマレーザーにエネルギー測定装置 をつけたことを特徴とするレーザー照射装置。

【請求項2】エキシマレーザーにエネルギー減衰装置を つけたことを特徴とするレーザー照射装置。

【請求項3】請求項2記載のエネルギー減衰装置のエネ ルギー減衰率が可変であることを特徴とするレーザー照 射装置。

【請求項4】エキシマレーザーにエネルギー測定装置と エネルギー減衰装置とをつけたことを特徴とするレーザ 10 一照射装置。

【請求項5】エキシマレーザーにエネルギー測定装置と エネルギー減衰率が可変であるエネルギー減衰装置とを つけたことを特徴とするレーザー照射装置。

【請求項6】請求項5記載のエネルギー測定装置とエネ ルギー減衰装置とが連動しており、レーザーエネルギー をある一定の値に保ってレーザー照射を行えることを特 徴とするレーザー照射装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、例えば半導体デバイス の作製する際に使用する、レーザー装置の構成に関す る。特に、本発明は、1部もしくは全部が非晶質成分か らなる半導体材料、あるいは、実質的に真性な多結晶の 半導体材料、さらには、イオン照射、イオン注入、イオ ンドーピング等によってダメージを受け、結晶性が著し く損なわれた半導体材料に対してレーザー光を照射する ことによって、該半導体材料の結晶性を向上せしめ、あ るいは結晶性を回復させる目的で使用するレーザー装置 の構成に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、半導体素子プロセスの低温化に関 して盛んに研究が進められている。その大きな理由は、 ガラス等の絶縁基板上に半導体素子を形成する必要が生 じたからである。その他にも素子の微小化や素子の多層 化に伴う要請もある。

【0003】半導体プロセスにおいては、半導体材料に 含まれる非晶質成分もしくは非晶質半導体材料を結晶化 させることや、もともと結晶性であったものの、イオン を照射したために結晶性が低下した半導体材料の結晶性 40 を回復することや、結晶性であるのだが、より結晶性を 向上させることが必要とされることがある。従来、この ような目的のためには熱的なアニールが用いられてい た。半導体材料として珪素を用いる場合には、600℃ から1100℃の温度で0.1~48時間、もしくはそ れ以上の時間のアニールをおこなうことによって、非晶 質の結晶化、結晶性の回復、結晶性の向上等がなされて きた。

【0004】このような、熱アニールは、一般に温度が 高いほど処理時間は短くても良かったが、500℃以下 50

の温度ではほとんど効果はなかった。したがって、プロ セスの低温化の観点からは、従来、熱アニールによって なされていた工程を他の手段によって置き換えることが 必要とされた。

[0005] レーザー光照射技術は究極の低温プロセス と注目されている。すなわち、レーザー光は熱アニール に匹敵する高いエネルギーを必要とされる箇所にのみ限 定して与えることができ、基板全体を高い温度にさらす 必要がないからである。レーザー光の照射に関しては、 大きく分けて2つの方法が提案されていた。

【0006】第1の方法はアルゴンイオン・レーザー等 の連続発振レーザーを用いたものであり、スポット状の ビームを半導体材料に照射する方法である。これはビー ム内部でのエネルギー分布の差、およびピームの移動に よって、半導体材料が溶融した後、緩やかに凝固するこ とによって半導体材料を結晶化させる方法である。第2 の方法はエキシマーレーザーのごときパルス発振レーザ ーを用いて、大エネルギーレーザーパルスを半導体材料 に照射し、半導体材料を瞬間的に溶融させ、凝固させる ことによって半導体材料を結晶化させる方法である。

[0007]

20

【発明が解決しようとする課題】第1の方法の問題点は 処理に時間がかかることであった。これは連続発振レー ザーの最大エネルギーが限られたものであるため、ピー ムスポットのサイズがせいぜいmm単位となったためで ある。これに対し、第2の方法ではレーザーの最大エネ ルギーは非常に大きく、したがって、数 c m 以上の大 きなスポットを用いて、より量産性を上げることができ る。しかしながら、通常用いられる正方形もしくは長方 形の形状のビームでは、1枚の大きな面積の基板を処理 するには、ビームを上下左右に移動させる必要があり、 量産性の面で依然として改善する余地があった。

【0008】これに関しては、ビームを線状に変形し、 ピームの幅を処理すべき基板を越える長さとし、このピ ームを走査することによって、大きく改善できる。改善 すべき問題として残されていたことはレーザー照射効果 の均一性である。エキシマレーザーに代表されるガスに 対して放電を行うことによってレーザー発振を行うパル ス発振レーザーは、パルスごとにエネルギーがある程度 変動する性質を有している。さらに、パルス発振レーザ ーは出力されるエネルギーによってそのエネルギーの変 動の度合いが変化する特性を有している。特にレーザー が安定に発振しにくいエネルギー領域で照射を行なう場 合、基板全面にわたって均一なエネルギーでレーザー処 理することは困難である。

【0009】パルス発振型のレーザーを使用するもうー つの問題点として、レーザーを長時間使用することによ って、レーザー発振に必要なガスが劣化し、レーザーエ ネルギーが下がってゆくことが挙げられる。このことに 関してはレーザーの出力を上げれば、レーザーエネルギ

ーも上がるので、問題ないように思われる。しかし、実際はレーザーの出力を変えるとしばらくの間レーザーの エネルギーが安定しなくなるので、この方法はあまり好ましくない。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明では、減光フィルターで代表されるエネルギー減衰装置とビームプロファイラーで代表されるエネルギー測定装置を組み合わせ用いることによって、これらの問題を解決する。即ち、本発明は、レーザーができるだけ安定する出力でレーザー 10発振を行ない、さらにエネルギー減衰装置を組み合わせ用いることで、レーザー強度を被照射物に対して最適なエネルギーに調節し照射する方法に関する。

【0011】なお、本発明の場合、エネルギー減衰装置 はエネルギー減衰率が連続可変であることが望ましい が、不連続可変でも良い。すなわち、本発明の概要はレ ーザーエネルギーを上記最適エネルギーより高く設定 し、エネルギー減衰装置を使用することで上記最適エネ ルギーに調節する。このとき、レーザーはできるだけ安 定に発振できるエネルギー領域で発振させる。そして、 レーザーを長時間発振し続けるとレーザーエネルギーが 低下してくる。この低下分をエネルギー減衰装置を調節 することで補うのが、本発明の主旨である。即ち、最終 的に低下してしまうエネルギーを最初の段階ではエネル ギー減衰装置で減衰させ、レーザー光の照射を続ける段 階において、徐々に減衰率を低下させていくことで、常 に一定のエネルギーでレーザー光を照射することを特徴 とする。であるから、エネルギー減衰装置が連続可変で ある方が好ましい。

[0012]

[実施例]

〔実施例1〕まず装置について説明する。図1には本実施例で使用するレーザーアニール装置の概念図を示す。 1がレーザーアニール装置の本体である。レーザー光は発振器2で発振される。発振器2で発振されるレーザー光は、KrFエキシマレーザー(波長248nm、パルス幅25ns)である。勿論、他のエキシマレーザーさらには他の方式のレーザーを用いることもできる。

【0013】発振器2で発振されたレーザー光は、全反射ミラー5、6を経由して増幅器3で増幅され、さらに 40全反射ミラー7、8を経由して光学系4に導入される。なお、図1中には示さなかったが、8と4との間にエネルギー減衰装置を挿入する。この機械の構造は図3に示す。

【0014】図3の装置は1枚のフィルターをレーザー ビームの進行方向に対してほば面を向け、その角度を変 えることでエネルギー透過率を変化させる方式ものであ る。

【0015】光学系に入射する直前のレーザー光のピームは、3×2cm¹程度の長方形であるが、光学系4によ 50

って、長さ8~30cm、幅0~0.5mm程度の細長いビーム (線状ビーム) に加工される。この光学系4を経たレーザー光のエネルギーは最大で1000mJ/ショットである。

[0016] レーザー光をこのような細長いビームに加工するのは、加工性を向上させるためである。即ち、線状のビームは光学系4を出た後、全反射ミラー9を経て、試料11に照射されるが、ビームの幅は試料の幅よりも長いので、試料を1方向に移動させることで、試料全体に対してレーザー光を照射することができる。従って、試料のステージ及び駆動装置10は構造が簡単で保守も用意である。また、試料をセットする際の位置合わせの操作(アラインメント)も容易である。

【0017】レーザー光が照射される試料のステージ10はコンピュータにより制御されており線状のレーザー 光に対してほぼ直角方向に動くよう設計されている。

【0018】光学系4の内部の光路を図2に示す。光学系4に入射したレーザー光はシリンドリカル凹レンズA、シリンドリカル凸レンズB、横方向のフライアイレンズC、Dを通過することによってレーザー光はそれまでのガウス分布型から短形分布に変化する。さらに、シリンドリカル凸レンズE、Fを通過してミラーG(図1ではミラー9に相当)を介して、シリンドリカルレンズHによって集束され、試料に照射される。

【0019】ミラーG(図1のミラー9に相当する)はレーザーエネルギーを少し透過できるようにできており、ミラーGの後ろにピームプロファイラーを置いて、レーザーを試料に照射中でもリアルタイムでレーザーエネルギーを測定できる。線状レーザーは面積も大きいので、ピームプロファイラーを線状レーザー内でスキャンさせることでエネルギーを測定する。(図4参照)こうすることで線状レーザー内のエネルギー分布も測定できる。

【0020】これらの装置はレーザー照射中、線状レーザーのエネルギーが設定エネルギーよりもある一定の割合以上ずれてくると自動的にピームスプリッターからエネルギー減衰装置に信号がきて、レーザーエネルギーを上記設定エネルギーに直すよう設計されている。

【0021】〔実施例2〕実施例1の方法で図1記載のミラーGに透過性をもたせることは、レーザー照射のエネルギーをリアルタイムで測定できる利点を持つ反面、レーザーエネルギーを損失してしまう欠点がある。そこで本実施例では、上記欠点を解消する装置配置について述べる。ただし、本実施例の装置配置だと試料照射中にリアルタイムで線状レーザービームのエネルギーを測定することはできなくなる。

[0022] 本実施例で使用する装置のレーザー照射部分を図5に示す。図5中のミラーPに図1のミラーGが対応する。ミラーPは全反射ミラーで、その下に4%反射ミラーQがある。ミラーQで折り返されたエネルギー

5

はビームプロファイラーRに入るようになっている。ミ 処理プロラーQはミラーPに比べるとサイズが小さい。というの は、ビームプロファイラーが一度に測定できる面積が小 さいからである。ミラーQはピームプロファイラーRと 運動していて、線状レーザーに沿って、線状レーザーよ りも広い範囲でスライドできるようになっている。ミラーQとピームプロファイラーRはレーザー照射時には線 状レーザーの外までスライドさせておく。ここで、もし 被照射物が線状レーザーの幅にたいして狭いものである は照射物が線状レーザーの幅にたいして狭いものである なら、照射に影響しない線状レーザーの端のところにミ 10 示す図ラーQを置くことで、レーザー照射中もエネルギーを測 ですることが可能となる。 [符号の

[0023]

【発明の効果】本発明のレーザー照射技術によって、レーザーエネルギーを極力一定に保ちながらレーザー処理を行うことが可能となった。この結果、レーザー処理工程の再現性が高まり、レーザー処理工程を経る製品のバラツキが著しく減ることが期待できる。本発明は特に、半導体デバイスのプロセスに利用される全てのレーザー

処理プロセスに有効に利用できる。なぜなら、上記プロセスはレーザーエネルギーのマージンが狭く、わずかなエネルギーの違いが特性に大きく影響するからである。 このように本発明は工業上、有益なものと考えられる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 レーザーアニール装置の概略を示す図

【図2】 光学系を示す図

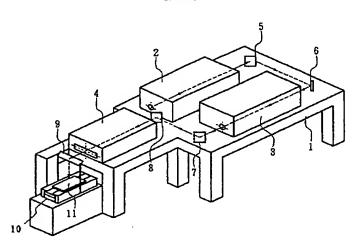
【図3】 減光フィルターを示す図

【図4】 線状レーザーのエネルギーを測定する状態を デオ図

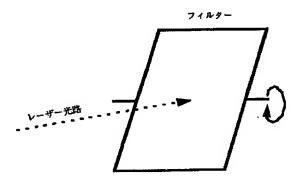
【図5】 レーザー照射装置の概略の構成を示す図 【符号の説明】

1	レーサー照射装置
2	レーザー光の発振器
3	レーザー光の増幅器
4	光学系
5, 6, 8, 9	全反射ミラー
1 0	ステージ
1 1	試料

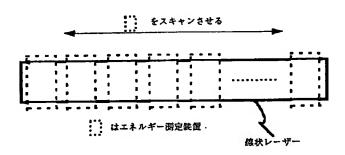
[図1]



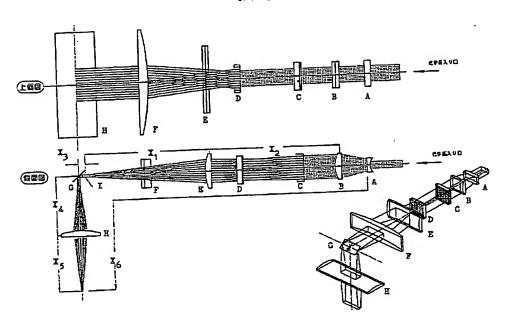
【図3】



【図4】



[図2]



[図5]

